|  |
| --- |
| 기술수요조사 안내문 |

|  |
| --- |
| 안녕하십니까?  산업통상자원부 산하의 한국산업기술평가관리원(이하 KEIT)은 산업기술 분야의 기술 기획과 정책 활동을 통해 국가 R&D사업이 우수한 연구 성과를 창출하도록 지원하고 있습니다.  이를 위해 산·학·연 전문가 분들의 일선 수요를 파악하여 국가연구개발사업의 과제발굴에 반영함으로써 기술·정책·경제적 활용성 및 실용화 가능성이 높은 기술개발 사업을 수행하고자 합니다.  특히, 국가연구개발사업 중 지식경제부의 **「소재부품기술개발사업」**은 유망한 소재·부품 R&D를 지원을 통한 국내 소재·부품 및 타 분야의 기술혁신과 경쟁력제고를 목표로 하고 있는 사업입니다.  2014년 「소재부품기술개발사업」의 과제발굴에 **귀하(기관)께서 제안하실 의견이 있으시면** 기술수요조사 양식을 참고하시어 **2014년 2월 24일(월)까지** [**jmrgem@keit.re.kr**](mailto:jmrgem@keit.re.kr) 으로 회신해 주시기 바랍니다.  귀하의 기술수요가 대한민국의 산업기술 R&D 발전 및 국민소득 4만불 달성의 견인차가 될 수 있음을 양지하시어 적극적인 수요제안을 부탁드립니다.  끝으로 귀하(기관)의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.  감사합니다.  2014. 1. 14  한국산업기술평가관리원장 |

|  |
| --- |
| 기술수요조사서 작성방법 |

**1. 제안 개요** : 제안하는 기술의 개요에 해당하는 내용이며, 사업구분은 다음 4개 세부사업 중에서 선택하여야 합니다.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구 분** | | **지원 기간** | **사업 개요** |
| **핵심소재** | **①전략적 핵심소재 기술개발** | 7년 이내 | ㅇ2020년 세계시장 3억불 이상 창출 가능하고 세계 시장점유율 70%이상 선점 가능한 독과점형 핵심소재 |
| **융복합**  **소재·부품** | **②SW융합형부품 기술개발** | 5년 이내 | ㅇ기존 부품이 가진 성능, 기능, 가치의 한계를 극복하기 위해 SW가 융합되어 부품의 지능화, 다기능화, 고부가가치화, 고신뢰화가 가능한 부품 |
| **③벤처형전문소재 기술개발** | 3년 내외 | ㅇ중소·중견 소재기업이 보유한 기술력을 바탕으로 경량화, 감성소재 등 고기능성 소재  \* 설계기술, 공정/가공기술, 평가기술 포함 |
| **④투자자 연계형 기술개발** | 3년 내외 | ㅇ개발 과제의 사업화 제고를 위하여 민간 자본의 사업성 평가(투자유치)를 접목한 투자기관 연계형 개발과제 |

\* 4개 사업에 대한 상세설명은 참고 참조

**2. 기술개요 및 필요성** : 제안하는 기술의 경제적․산업적 중요성과 이에 따른 연구개발의 정부 지원 필요성을 구체적으로 기술하여야 합니다.

**3. 목표 및 내용**

가. 개발목표 : 개발 하고자 하는 기술(또는 공정)의 수준․성능 및 품질을 가능한 한 정량적으로 기술하여야 합니다.

나. 개발내용 : 기술개발의 목표를 달성하기 위하여 수행할 세부기술의 내용 및 범위를 기술하고, 연구개발 예정품에 대한 사양․성능․용도 및 기능 등에 대하여 기술하여야 합니다.

**4. 제안기술 개발동향**

가. 기술개발 동향 : 제안하는 기술에 대한 국내․외의 연구개발 현황, 문제점 및 향후전망 등을 기술하여야 합니다.

나. 경쟁기술현황 : 제안기술에 대응하는 경쟁기술의 국내외 현황을 기술하여야 합니다.

**5. 적용산업(분야) 및 기대효과**

가. 적용산업(분야) : 제안하는 기술의 개발완료시 적용 가능한 구체적인 산업 또는 분야를 제시하여야 합니다.

나. 기대효과 : 해당분야의 매출증대, 국산화율, 국내외 경쟁력, 시장점유율 등을 제시하여야 합니다.

**[참고] 소재부품기술개발 4개 세부사업 개요**

**① 전략적 핵심소재 기술개발**

|  |
| --- |
| **□ 사업목적**  ㅇ 기술개발 성공시 세계시장 독과점이 가능하나 민간 스스로 개발하기에 리스크가 큰 전략적 핵심소재 개발  \* 전략적 핵심소재 : ’20년 세계시장 3억불 이상 창출가능하며, 시장 점유율 70% 이상 달성 가능한 세계시장 독과점형 핵심소재  **□ 지원방향**  ㅇ 중소·중견기업의 정부출연금 활용비율을 50% 이상으로 하고, 기술개발단계부터 수요기업 참여를 의무화  **□지원규모 및 기간**  ㅇ 연간 14억원 내외, 총 7년 이내 지원 |

**② SW융합형부품 기술개발**

|  |
| --- |
| **□ 사업목적**  ㅇ 자동차·조선, 기계, 전기전자 및 정보통신 부품과 SW를 결합한 미래 성장동력형 핵심부품 개발  **□ 지원방향**  ㅇ 중소·중견기업을 주관기관으로 선정하여 정부출연금 활용비율을 70% 이상 지원  ㅇ 기획부터 R&D 전주기에 신뢰성 검증 및 수요기업 참여 의무화  **□지원규모 및 기간**  ㅇ 연간 11억원 내외, 총 5년 이내 지원 |

**③ 벤처형 전문소재 기술개발**

|  |
| --- |
| **□ 사업목적**  ㅇ 중소·중견 소재기업이 특정분야 및 틈새시장에서 세계최고 수준의 기술력을 갖춘 소재 중핵기업으로 성장할 수 있도록 지원  **□ 지원방향**  ㅇ 기술개발 초기부터 수요기업과의 선제적 협력을 통한 개발소재의 적용 및 시장진입 연계를 위해 수요기업이 반드시 참여기관으로 사업 참여  **□지원규모 및 기간**  ㅇ 연간 5억원 내외, 총 3년 이내 지원 |

**④ 투자자연계형 기술개발**

|  |
| --- |
| **□ 사업목적**  ㅇ 기업 매출·영업이익률 향상 및 글로벌 경쟁력 확보가 가능하고, 무역역조 해소에 기여하는 소재·부품 기술개발  **□ 지원방향**  ㅇ 개발 과제의 사업화 제고를 위하여 민간 자본의 사업성 평가(투자유치)를 접목한 투자기관 연계형 개발과제 지원  **□지원규모 및 기간**  ㅇ 연간 6억원 내외, 총 3년 내외 지원 |

2014년도 소재부품기술개발사업 기술수요조사서

(2페이지 내외 작성)

**1. 제안 개요**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **제안기술명** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **제안기관** | **기관명** | **지역** | | | | | | | | | **기관유형** | | | | |
|  | 국  내 | 서울 | ( ) | 부산 | ( ) | 대구 | ( ) | 인천 | ( ) | | 대기업 | ( ) | 중견기업 | ( ) |
| 대전 | ( ) | 울산 | ( ) | 광주 | ( ) | 경기 | ( ) | |
| 중소기업 | ( ) | 대학교 | ( ) |
| 강원 | ( ) | 충남 | ( ) | 충북 | ( ) | 전남 | ( ) | |
| 정부기관 | ( ) | 연구소 | ( ) |
| 전북 | ( ) | 경남 | ( ) | 경북 | ( ) | 제주 | ( ) | |
| 협회 | ( ) | 기타 | ( ) |
| 국 외 | | *(국 가 명)* | | | | | | | |
| **사업구분** | 1. **①**전략적 핵심소재 기술개발사업( ) **②**SW 융합형 부품 기술개발사업( )   **③**벤처형 전문소재 기술개발사업( ) **④**투자자 연계형 기술개발사업( ) | | | | | | | | | | | | | | |
| **기술분류** | **소재** | 화학(섬유 포함)( ), 금속( ), 세라믹( ), 융합( ) | | | | | | | | | | | | | |
| **부품** | 자동차·조선( ), 기계·로봇( ), 전기전자( ), 휴먼 인터렉션( ) | | | | | | | | | | | | | |
| **산업기술분류표(code)** | | | | | | | | | | | | | | |
| *대분류 - 중분류 - 소분류 ex. (정보통신) - (이동통신) - (이동통신 시스템)* | | | | | | | | | | | | | | |

**2. 기술개요 및 지원 필요성**

|  |
| --- |
| *기술의 제안 배경 및 정부 지원의 필요성 등에 대해 작성* |

**3. 목표 및 내용**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **개발목표** | *기술개발을 통해 달성하고자 하는 소재·부품·모듈 및 이의 상세 스펙 등을 기재* | | |
| **개발내용** | *개발목표에 따른 기술내용 기재* | | |
| **총 기술개발 기간** | ( )년 | **총 소요 금액(정부출연금 기준)** | ( )억원 |

**4. 국내·외 동향** *제안 기술에 대한 국내·외의 개발 및 시장 동향, 문제점 및 향후전망 등을 작성*

|  |  |
| --- | --- |
| **국내 동향**  **(한국)** |  |
| **해외 동향** |  |

**5. 적용산업 또는 분야 및 기대효과**

|  |
| --- |
| *제안기술의 개발완료시 적용 가능한 구체적인 산업 또는 분야*  *향후 기대 효과에 대해 작성*  *ex. 자동차 샤시, 디스플레이 패널 등, 매출증대, 사업화 투자 계획, 국산화율, 국내외경쟁력,*  *시장점유율, 활용분야 등* |

**6. 제안자 인적사항**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **성 명/직 책** |  | | | |
| **연 락 처** | TEL) |  | E-mail) |  |